

# Übersicht Warengliederung

<b>1</b>	<b>Materialien</b>	<b>4</b>	<b>Inspektions- und Testsysteme</b>
<b>2</b>	<b>Herstellungsverfahren und -technik</b>	<b>5</b>	<b>Bauelemente/Geräte</b>
<b>3</b>	<b>Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration</b>	<b>6</b>	<b>Anwendungen</b>
		<b>7</b>	<b>Dienstleistungen und Services</b>

## Warengliederung

- |                                |                                           |                                 |                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b>                       | <b>Materialien</b>                        | 2.2                             | Digitale Druckverfahren                       |
| 1.1                            | Substrate                                 | <input type="checkbox"/> 2.2.1  | Inkjetdruck                                   |
| <input type="checkbox"/> 1.1.1 | Plastikfolien                             | <input type="checkbox"/> 2.2.2  | Sonstige digitale Druckverfahren              |
| <input type="checkbox"/> 1.1.2 | Metallfolien                              | 2.3                             | Sonstige Druckverfahren                       |
| <input type="checkbox"/> 1.1.3 | Papier                                    | <input type="checkbox"/> 2.3.1  | Mikrokontaktdruck                             |
| <input type="checkbox"/> 1.1.4 | Glas                                      | <input type="checkbox"/> 2.3.2  | Nano imprint                                  |
| <input type="checkbox"/> 1.1.5 | Textilien                                 | 2.4                             | Vakuumprozesse                                |
| <input type="checkbox"/> 1.1.6 | Sonstige Substrate                        | <input type="checkbox"/> 2.4.1  | Aufdampfverfahren                             |
| 1.2                            | Leitende Materialien                      | <input type="checkbox"/> 2.4.2  | Sputtering                                    |
| <input type="checkbox"/> 1.2.1 | Organische Leiter                         | <input type="checkbox"/> 2.4.3  | Organic vapor phase deposition (OVPD)         |
| <input type="checkbox"/> 1.2.2 | Anorganische Leiter                       | <input type="checkbox"/> 2.4.4  | Sonstige Vakuumprozesse                       |
| <input type="checkbox"/> 1.2.3 | Nanomaterialien                           | <input type="checkbox"/> 2.5    | Fotolithografie                               |
| <input type="checkbox"/> 1.2.4 | Carbon Nanotubes                          | 2.6                             | Laserverfahren                                |
| <input type="checkbox"/> 1.2.5 | Graphen                                   | <input type="checkbox"/> 2.6.1  | Laserablation                                 |
| <input type="checkbox"/> 1.2.6 | Hybride Leiter                            | <input type="checkbox"/> 2.6.2  | Lasertransfer                                 |
| 1.3                            | Halbleiter                                | 2.7                             | Beschichtungsverfahren                        |
| <input type="checkbox"/> 1.3.1 | Polymere Halbleiter                       | <input type="checkbox"/> 2.7.1  | Rotationsbeschichtung (Spin coating)          |
| <input type="checkbox"/> 1.3.2 | Halbleiter (kleine Moleküle)              | <input type="checkbox"/> 2.7.2  | Tauchbeschichtung (Dip coating)               |
| <input type="checkbox"/> 1.3.3 | Anorganische Halbleiter                   | <input type="checkbox"/> 2.7.3  | Rakelbeschichtung (Blade coating)             |
| <input type="checkbox"/> 1.3.4 | Nanohalbleiter                            | <input type="checkbox"/> 2.7.4  | Sonstige Beschichtungsverfahren               |
| <input type="checkbox"/> 1.3.5 | Carbon Nanotubes (Halbleiter)             | 2.8                             | Materialverarbeitung                          |
| <input type="checkbox"/> 1.3.6 | Hybride Halbleiter                        | <input type="checkbox"/> 2.8.1  | Dispergiertechnik                             |
| 1.4                            | Dielektrika                               | <input type="checkbox"/> 2.8.2  | Sonstige Materialverarbeitung                 |
| <input type="checkbox"/> 1.4.1 | Organische Dielektrika                    | 2.9                             | Photoinduzierte Prozessierung                 |
| <input type="checkbox"/> 1.4.2 | Anorganische Dielektrika                  | <input type="checkbox"/> 2.9.1  | IR Trocknungsverfahren                        |
| <input type="checkbox"/> 1.4.3 | Nanomaterialien                           | <input type="checkbox"/> 2.9.2  | UV Verfahren                                  |
| <input type="checkbox"/> 1.4.4 | Hybride Dielektrika                       | <input type="checkbox"/> 2.9.3  | Laserverfahren                                |
| 1.5                            | Verkapselungsmaterialien und Kleber       | 2.10                            | Dosier- und Mischtechnik                      |
| <input type="checkbox"/> 1.5.1 | Dünnschichtverkapselung                   | <input type="checkbox"/> 2.10.1 | Pumpen                                        |
| <input type="checkbox"/> 1.5.2 | Polymerverkapselung                       | <input type="checkbox"/> 2.10.2 | Sonstige Dosier- und Mischtechniken           |
| <input type="checkbox"/> 1.5.3 | Metallverkapselung                        | 2.11                            | Verkapselungstechnik                          |
| <input type="checkbox"/> 1.5.4 | Glasverkapselung                          | <input type="checkbox"/> 2.11.1 | Dünnschichtverkapselung                       |
| <input type="checkbox"/> 1.5.5 | Kleber                                    | <input type="checkbox"/> 2.11.2 | Polymerverkapselung                           |
| <input type="checkbox"/> 1.6   | Sonstige Materialien                      | <input type="checkbox"/> 2.11.3 | Metallverkapselung                            |
|                                |                                           | <input type="checkbox"/> 2.11.4 | Glasverkapselung                              |
|                                |                                           | <input type="checkbox"/> 2.11.5 | Sonstige Verkapselungstechniken               |
| <b>2</b>                       | <b>Herstellungsverfahren und -technik</b> | <input type="checkbox"/> 2.12   | Reinraumtechnik                               |
| 2.1                            | Massendruckverfahren                      | <input type="checkbox"/> 2.13   | Rolle-zu-Rolle-Verfahren                      |
| <input type="checkbox"/> 2.1.1 | Tiefdruck                                 | <input type="checkbox"/> 2.14   | Sonstige Herstellungsverfahren und -techniken |
| <input type="checkbox"/> 2.1.2 | Offsetdruck                               |                                 |                                               |
| <input type="checkbox"/> 2.1.3 | Flexodruck                                |                                 |                                               |
| <input type="checkbox"/> 2.1.4 | Siebdruck                                 |                                 |                                               |
| <input type="checkbox"/> 2.1.5 | Sonstige Massendruckverfahren             |                                 |                                               |

# Warengliederung

info@lopec.com, Tel. +49 89 949-20364

Messe München GmbH, Am Messesee 2, 81829 München, Deutschland

- 3 Elektronikfertigung, Aufbau- und Verbindungstechnik, Systemintegration**
  - 3.1 Elektrische Verbindungstechnik
    - 3.1.1 Flip Chip
    - 3.1.2 Sonstige Verbindungstechniken
  - 3.2 Laminierung
  - 3.3 Systemintegration
  - 3.4 Hybride Systeme (Polytronik)
  
- 4 Inspektions- und Testsysteme**
  - 4.1 Elektrische Charakterisierung
  - 4.2 Physikalische/Optische Charakterisierung
  - 4.3 Chemische Charakterisierung
  - 4.4 Simulation/Schaltkreisoptimierung
  - 4.5 Lebensdauertest
  - 4.6 Qualitäts-/Prozesskontrolle
  - 4.7 Umweltprüfverfahren
  - 4.8 Sonstige Inspektions- und Testsysteme
  
- 5 Bauelemente/Geräte**
  - 5.1 Transistoren
  - 5.2 Dioden
  - 5.3 Passive Bauelemente
    - 5.3.1 Kondensatoren
    - 5.3.2 Widerstände
    - 5.3.3 Sonstige passive Bauelemente
  - 5.4 Integrierte Schaltkreise
  - 5.5 Displays
    - 5.5.1 OLED
    - 5.5.2 Elektrophoretische Displays
    - 5.5.3 Elektrochrome Displays
    - 5.5.4 Elektrolumineszenz-Displays
    - 5.5.5 LCD
    - 5.5.6 Electrowetting
    - 5.5.7 Sonstige Displays
  - 5.6 Photovoltaikzellen
    - 5.6.1 Organische Photovoltaikzellen
    - 5.6.2 Hybride Photovoltaikzellen
    - 5.6.3 Anorganische Photovoltaikzellen
  
- 5.7 Sensoren
  - 5.7.1 Fotodioden
  - 5.7.2 Drucksensoren
  - 5.7.3 Temperatursensoren
  - 5.7.4 Biomedizinische Sensoren
  - 5.7.5 Gassensoren
  - 5.7.6 Berührungssensoren
  - 5.7.7 Sonstige Sensoren
  - 5.8 Speicherbausteine
  - 5.9 Antennen
  - 5.10 Batterien
  - 5.11 Komponenten für hybride Systeme
  - 5.12 Sonstige Bauelemente
  
- 6 Anwendungen**
  - 6.1 TFT Backplanes
  - 6.2 Displays
  - 6.3 Sensoren
  - 6.4 Intelligente Systeme
  - 6.5 RFID
  - 6.6 Solarzellen
  - 6.7 Intelligente Textilien
  - 6.8 Lautsprecher
  - 6.9 Beleuchtung
  - 6.10 Sonstige Anwendungen
  
- 7 Dienstleistungen und Services**
  - 7.1 Consulting
  - 7.2 F&E Förderprogrammmanagement
  - 7.3 F&E/Forschung & Entwicklung
  - 7.4 Prototypenentwicklung
  - 7.5 Auftragsfertigung
  - 7.6 Kapital- und Risikobeteiligungsformen
  - 7.7 Fachvereinigungen und -verbände
  - 7.8 Fachbücher, Fachzeitschriften, Fachverlage
  - 7.9 Sonstige Dienstleistungen